

**Dk 3.34 Df 0.0037  
@13GHz**

**Tg(DSC) 185°C**

**T288(含铜)  
>120分钟**

**应用**  
**网络/无线通信**  
ICT 基础设施设备, 超级计算机, 测量仪器, 天线(基站、车载毫米波雷达)等

# MEGTRON6

芯板

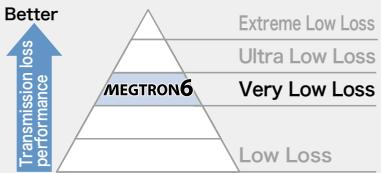
**R-5775(N)\* R-5775(K) R-5775(G)**

半固化片

**R-5670(N)\* R-5670(K) R-5670(G)**

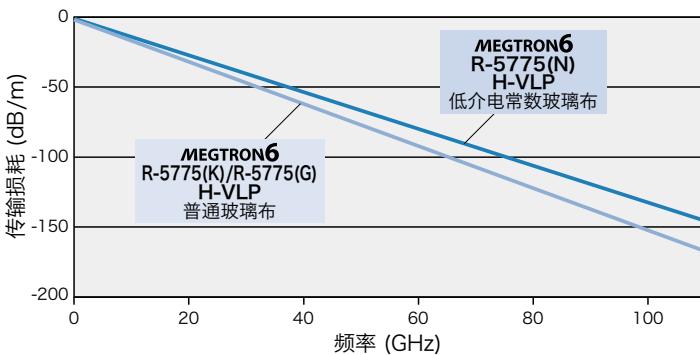
\*低介电常数玻璃布类型

## 超低传输损耗·高耐热性多层基板材料



基于超低传送损失, 高耐热性, 高可靠性的高速材料行业通用产品。

### 传输损耗比较



### 叠构



层1: 信号线层

(线宽: 270μm、铜箔厚度: 24μm)

层2: GND平面层

(铜箔厚度: 24μm)

测定方法	2端口 S参数
测定频率	10MHz~110GHz
校正方法	TRL法
阻抗匹配	调整到 50Ω(Zo)

### 高多层耐热性

#### 结果

孔径	φ0.3mm	
通孔壁间距离	0.5mm	0.6mm
MEGTRON6 (低介电常数玻璃布)	合格	合格

#### 条件

260°C回流焊×10次

#### 叠构

32层

板厚: 4.5mm



### 一般特性

项目	试验方法	条件	单位	MEGTRON6 R-5775(N) 低介电常数玻璃布	MEGTRON6 R-5775(K)/R-5775(G) 普通玻璃布
玻璃态转化温(Tg)	DSC	A	°C	185	185
热膨胀系数(Z-轴方向)	α1	IPC-TM-650 2.4.24	A	ppm/°C	45
	α2				260
T288(含铜)	IPC-TM-650 2.4.24.1	A	分钟	>120	>120
介电常数(Dk)	13GHz	平衡型圆盘共振法	C-24/23/50	-	3.34
介质损耗因数(Df)					0.0037
铜箔剥离强	1oz(35μm)	IPC-TM-650 2.4.8	A	kN/m	0.8 [H-VLP]
试验片厚度为0.75mm。					

在使用本产品时, 请在我公司网站上确认注意事项。

[industrial.panasonic.com/ea/electronic-materials](http://industrial.panasonic.com/ea/electronic-materials)

松下电器机电 MEGTRON6

上述数据为本公司测量所得的代表值, 非保证值。

© Panasonic Industry (China) Co., Ltd. 202503